

車載搭載製品の軽薄短小化にも対応『M53』ペースト

M53 series solder paste that is capable of being applied to small-sized and lightweight on-board products

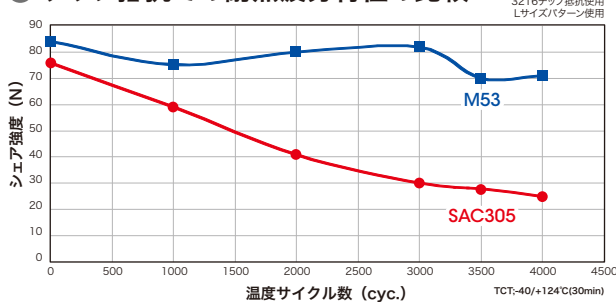
特長

- 耐熱疲労特性に優れ、過酷な使用条件でも高い接合強度を維持
- 熱疲労によるクラック進展を抑制、長期使用でも電気伝導を維持
- ランド面積の小さな軽薄短小化設計でも高い品質を確保



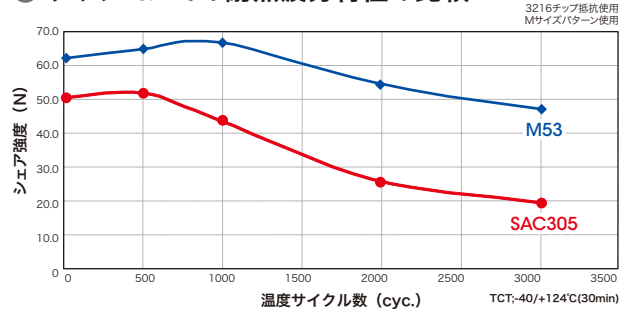
仕様

● チップ抵抗での耐熱疲労特性の比較



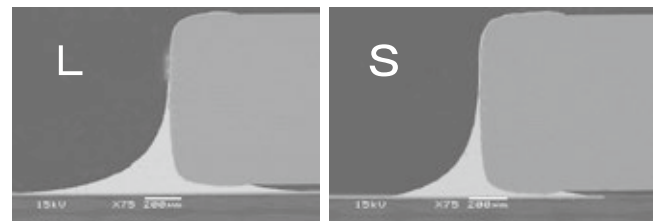
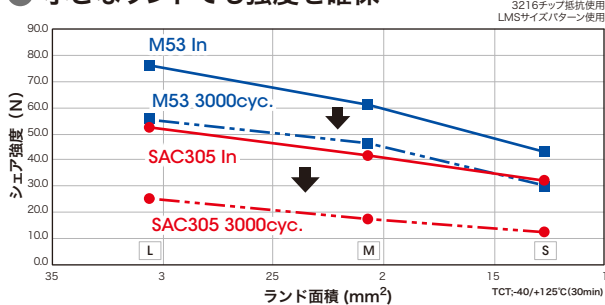
BiとInを添加したM53は、SAC305と比較し強度低下傾向が認められない

● チップコンでの耐熱疲労特性の比較



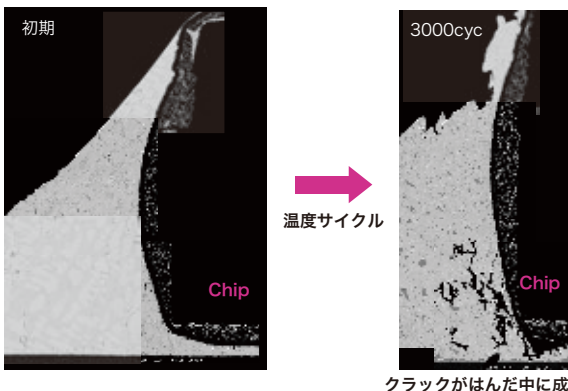
BiとInを添加したM53は、SAC305と比較して良好なシェア強度を保持

● 小さなランドでも強度を確保



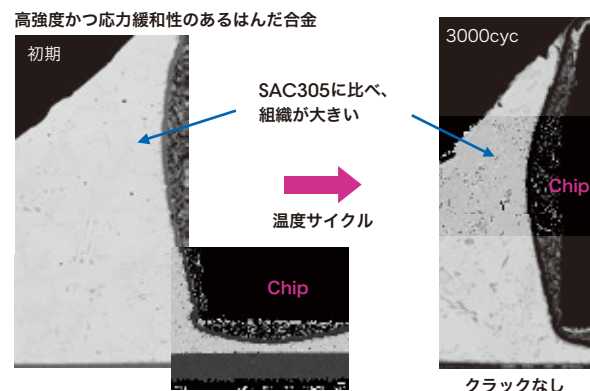
● 断面観察写真比較

SAC305



クラックがはんだ中に成長

M53



クラックなし